



平成 30 年 11 月 5 日

各 位

会社名 内外テック株式会社
代表者名 代表取締役社長 岩井田 克郎
(JASDAQ・コード3374)
問合せ先 取締役 佐々木 政彦
電 話 03-5433-1123 (代表)

業績予想の修正に関するお知らせ

最近の業績動向を踏まえ、平成 30 年 5 月 14 日に公表いたしました平成 31 年 3 月期（平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日）の第 2 四半期累計連結業績予想及び通期連結業績予想を修正いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 業績予想の修正について

(1) 平成 31 年 3 月期第 2 四半期累計期間連結業績予想数値の修正（平成 30 年 4 月 1 日～平成 30 年 9 月 30 日）

	売 上 高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 四半期純利益	1 株当たり 四半期純利益
前回発表予想 (A)	百万円 15,681	百万円 531	百万円 530	百万円 349	円 銭 119.25
今回修正予想 (B)	13,565	462	457	290	99.34
増減額 (B - A)	△2,116	△69	△73	△58	—
増減率 (%)	△13.5	△13.1	△13.9	△16.7	—
(ご参考)前期第 2 四半期実績 (平成 30 年 3 月期第 2 四半期)	13,358	637	624	415	166.70

(2) 平成 31 年 3 月期通期連結業績予想数値の修正（平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日）

	売 上 高	営業利益	経常利益	親会社株主に 帰属する 当期純利益	1 株当たり 当期純利益
前回発表予想 (A)	百万円 33,168	百万円 1,415	百万円 1,419	百万円 940	円 銭 320.99
今回修正予想 (B)	28,450	1,070	1,065	700	238.80
増減額 (B - A)	△4,718	△345	△354	△240	—
増減率 (%)	△14.2	△24.4	△25.0	△25.6	—
(ご参考)前期実績 (平成 30 年 3 月期)	28,426	1,202	1,184	857	316.31

2. 修正の理由

当第2四半期連結累計期間における業績につきましては、半導体・半導体製造装置市場は総じて好調を持続しましたが、DRAMを中心としたメモリの需給バランス調整から一部の半導体メーカーで設備投資に慎重な動きも見られるなど、第2四半期において半導体製造装置メーカーからの受注が期初計画に対し下方に推移したことに加え、今後の半導体需要増を見据え、人材の採用を中心とした営業・管理・製造体制強化に係る投資を推進したことにより、前回発表の業績予想を下回る見込みとなりました。このため、平成31年3月期の第2四半期累計期間連結業績予想につきまして、売上高・営業利益・経常利益・親会社株主に帰属する四半期純利益をそれぞれ上記のとおり修正いたします。

また、通期連結業績予想につきましても、第3四半期以降の半導体メーカーの設備投資動向を慎重に考慮し、上記のとおり修正いたします。

なお、平成31年3月期配当予想の変更はございません。

当社グループは、IoT市場の拡大など、中長期的な半導体需要の拡大基調に変わりがないことを見据え、引き続き、当社グループの受託製造機能における増産態勢整備などに積極的に取り組んでまいります。

(注) 本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は今後の様々な要因によって異なる可能性があります。

以 上